

EPOXY 4044

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para aplicaciones de impresión
- Epoxi de una sola pieza
- Curado térmico
- Alta resistencia mecánica al desprendimiento (corte o cizalla)
- Para aplicaciones de uso robusto
- Compatible con equipos de colocación a alta velocidad
- Cumple con las normas REACH and ROHS

DESCRIPCIÓN

El epoxi 4044 es un adhesivo epoxi de una sola pieza usado para unir componentes SMT a un PCB antes del reflujo doble cara o del proceso de soldadura por ola. El epoxi 4044 está formulado para resistir el adelgazamiento por corte y tiene propiedades de curado térmico rápido. La viscosidad y la tensión superficial del Epoxy 4044 proporcionan la fuerza de adherencia necesaria para su uso con equipos de colocación a alta velocidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Parámetro	Valor
Visual	Líquido espeso
Olor	Aromático (ligeramente)
Color	Rojo
Viscosidad	600-1,000 kcps
Gravedad Específica	1.13 (agua = 1) Típico
Punto de Ebullición	>260°C

PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro	Valor
Punto de deflexión de calor	97°C Típico
Resistencia a la tracción	11,500 psi Típico
Elongación %	4.6 Típico
Módulo de tracción	4.9 psi x 10 ⁵ Típico
Curado por 90 segundos	150°C Típico
Fuerza de desprendimiento - C1206	≈ 12 lbs Típico
5°Resistencia al desprendimiento (cizalla) - C1206	≈ 6 lbs Típico
Torque: IPC SM817 TM-650 2.4.42:	C-1206 bar FR4 (in.oz.) 11 Típico

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil (no refrigerada)	6 meses	Temperatura ambiente

Este producto no debe ser refrigerado. No se debe almacenar cerca de fuego. Debe mantenerse alejado de la luz solar, ya que esta puede degradar el producto. No mezcle adhesivo nuevo con adhesivo usado en el mismo recipiente. Si el material se endurece o cristaliza, puede recalentarse a 40°C (104°F) durante 8 horas, hasta que esté en condiciones de uso.

APLICACIÓN

El Epoxy 4044 se entrega listo para usar, y está disponible en jeringas, cartuchos y tarros. Cuando esté imprimiendo en el estencil, utilice un estencil limpio y aplique un depósito uniforme de 1/2" de diámetro de epoxi. La resistencia del adhesivo variará dependiendo del tipo de componente, tamaño del punto adhesivo, curado y tipo de máscara de soldadura.

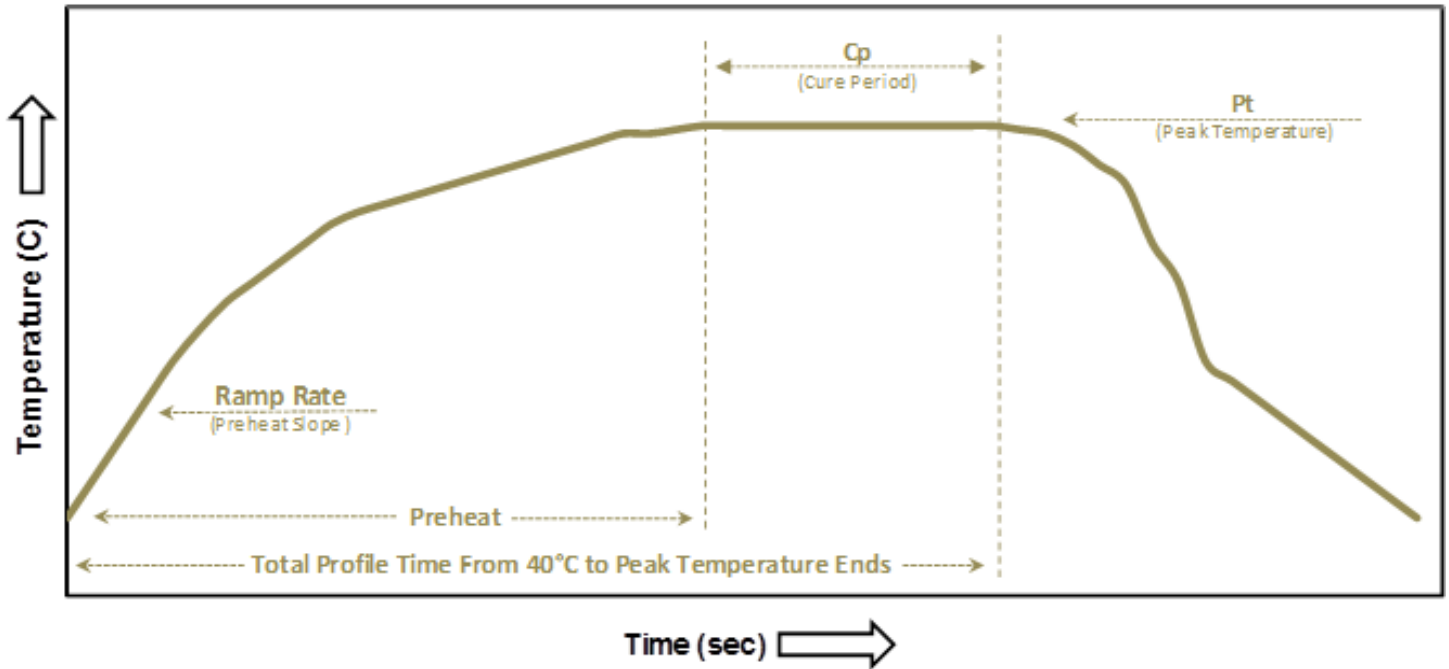
LIMPIEZA

El adhesivo sin curado puede ser removido de la PCB con alcohol isopropílico. La remoción de epoxy curado o de componentes adheridos puede ser realizada mediante la aplicación de calor a 120°C (250°F), que ablandará el epoxy 4044 para facilitar su remoción.

SEGURIDAD

Usar en un área con ventilación adecuada y equipo de protección personal adecuado. Para información de emergencia, consulte la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente. Disponga de cualquier material peligroso en contenedores autorizados.

PERFIL DE CURADO RECOMENDADO



Características del perfil	Parámetros
Rampa de calentamiento	1°C-2.5°C/segundos
Precalentar desde 40°C to 100°C	40-80 segundos
Precalentar desde 100°C to 120°C	50-70 segundos
Temperatura máxima f (Tp)	120°C-125°C
Tiempo de exposición a temperatura máxima	60 segundos
Tiempo total del perfil	2.5-3.5 minutos

*La información que se proporciona sobre perfiles debe ser empleada solo como referencia. Su perfil puede diferir debido a variables de proceso y de materiales.